

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



## SEMICONDUCTOR MANUFACTURING INTERNATIONAL CORPORATION

中芯國際集成電路製造有限公司\*

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：00981)

### 海外監管公告

本公告乃中芯國際集成電路製造有限公司 (Semiconductor Manufacturing International Corporation, 「本公司」) 根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條作出。

茲載列本公司於上海證券交易所網站刊發的《2024年度“提質增效重回報”行動方案》，僅供參閱。

承董事會命  
中芯國際集成電路製造有限公司  
公司秘書 / 董事會秘書  
郭光莉

中國上海， 2024年3月28日

於本公告日期，本公司董事分別為：

#### 執行董事

劉訓峰

#### 非執行董事

魯國慶

陳山枝

楊魯閩

#### 獨立非執行董事

劉遵義

范仁達

劉明

吳漢明

\* 僅供識別

# 中芯国际集成电路制造有限公司

## 2024 年度“提质增效重回报”行动方案

中芯国际集成电路制造有限公司（以下简称“公司”）积极贯彻落实科创板上市公司“提质增效重回报”专项行动，践行“做强做优做大中芯国际，代表行业参与国际竞争”的初心使命，在经营管理、研发创新、公司治理及投资者关系等方面采取积极措施，以进一步提高公司质量，保障投资者权益，促进公司健康可持续发展。主要举措如下：

### 一、 聚焦集成电路代工主业，深耕服务全球客户

公司是世界领先的集成电路晶圆代工企业之一，也是中国大陆集成电路制造业领导者。基于国际化运营的理念，为全球客户服务，建立了辐射全球的服务基地与运营网络。公司全面服务集成电路产业链，高度重视与上下游企业的合作，为提高产业链的韧性、可靠性和可持续性添砖加瓦，积极提升产业链整合与布局的能力，构建紧密的集成电路产业生态，为客户提供全方位、一体化的集成电路解决方案。根据全球各纯晶圆代工企业最新公布的 2023 年销售额情况排名，公司位居全球第四位，在中国大陆企业中排名第一。

2024 年，公司将继续坚定践行“做强做优做大中芯国际，代表行业参与国际竞争”的初心使命，站在未来发展的角度来谋划今天的业务布局、站在对标头部企业的高度来检视自身存在的差距、站在产业链生态圈的视角来选择与谁同行，聚焦“稳住产能、控制成本、技术

领先、客户至上”四个关键抓手，打造技术领先、制造能力、成本最优的核心竞争力，继续推进近几年来已宣布的 12 英寸工厂和产能建设计划。在外部环境无重大变化的前提下，预计销售收入较上年增幅不低于可比同业的平均值，实现同比中个位数增长，积极推进产能利用提升，提高出货量。

## 二、 持续研发创新投入，促进提升新质生产力

公司多年来专注于集成电路工艺技术的开发，成功开发了 8 英寸和 12 英寸多种技术节点，应用于不同工艺技术平台，具备逻辑电路、电源/模拟、高压驱动、嵌入式非挥发性存储、非易失性存储、混合信号/射频、图像传感器等多个技术平台的量产能力，可为客户提供智能手机、物联网、电脑与平板、消费电子、互联与可穿戴、工业与汽车等不同领域集成电路晶圆代工及配套服务。近三年，公司研发投入合计超过 140 亿人民币。2023 年，28 纳米超低功耗平台项目、40 纳米嵌入式存储工艺汽车平台项目、4X 纳米 NOR Flash 工艺平台项目、55 纳米高压显示驱动汽车工艺平台项目等已完成研发，进入小批量试产。目前公司 8 英寸、12 英寸在研项目包括：28 纳米超低漏电平台、55 纳米高压显示第二代工艺平台、65 纳米射频绝缘体上硅工艺平台、0.18 微米嵌入式存储工艺车用平台等。

2024 年，公司将持续投入研发创新，因地制宜发展新质生产力，加快实施创新驱动发展战略，用新技术提升产品多元化、稳定性、安全性和可靠性，持续优化公司产品和产能建设组合结构，为公司提升

抗周期能力、把握下一轮市场机遇和提升市场占有率打牢基础、做好准备。

### **三、 不断提升公司治理水平，提高上市公司质量**

公司为一家设立于开曼群岛并在香港联交所及上海证券交易所科创板两地上市的红筹企业，现行的公司治理制度主要系基于公司注册地和境外上市的相关法律法规及规则制定。公司一直高度重视公司治理水平的提升和完善，不断强化在内控制度、规范运作等方面的合规管理。

2024年，公司将建立监管动态跟踪反馈机制，定期收集、分析两地资本市场最新监管政策及法律法规，适时传递给主要股东、董事、管理层及相关业务部门。同时，公司将进一步加强董事、高管及子公司董监高的学习培训力度，帮助“关键少数人员”提升履职技能和合规知识储备，推动公司整体治理水平的全面提升。

### **四、 加强投资者双向沟通，构建多层次沟通渠道**

公司设有专业团队进行投资者关系管理工作，持续与资本市场沟通公司经营管理状况、财务状况、产品技术、产能建设等事项信息，并且主动披露投资者关心的市场和公司相关信息，充分保护投资者合法权益，稳定和提升资本市场信心。公司不仅通过线上线下多渠道向投资者传递公司可期待的成长性价值，并且定期收集投资者意见和反馈，形成资本市场双向沟通机制，发挥桥梁作用，定期呈报管理层，

实现资本市场助力上市公司质量提升。例如公司定期举办的线上业绩说明会，从财务、市场和运营的角度多方位解读公司业绩和行业动向，管理层也实时解答投资者关注的主要问题，实现了即时的双向沟通。且会后公司将会议纪要及时上传至上交所 e 互动平台，充分体现了公司重视资本市场和公平公开交流的态度。此外，公司亦积极倡导主要股东关注资本市场信息和诉求，助力增强资本市场内在稳定性。

2024 年，公司将召开不少于三次业绩说明会，公司管理层与全球投资者进行沟通交流。此外，公司将通过公告、股东大会、上证 e 互动、投资者热线和邮箱、公司官网、企业微信公众号、路演、反路演、调研、券商大会、宣传资料、媒体采访等多渠道进一步加强管理、运行和维护投资者关系，实现公平、真诚、及时、准确的沟通，尊重资本市场和半导体行业规律，增强投资者对公司的信心和信任，吸引更多的投资者特别是中长期资金参与，努力夯实资本市场高质量发展基础，坚定不移助力公司管理运营，为股东长期价值服务。

## **五、 贯彻落实“ESG”理念，实现公司可持续发展**

公司一直坚定地贯彻落实“ESG”理念，已连续 8 年披露企业社会责任报告/ESG 报告。近年来，在国家“双碳”政策的引导下，公司基于自身业务发展情况和未来规划，结合芯片行业变化趋势，对环境目标进行灵活调整，持续推进节能减排，贯彻落实可持续发展理念。

2024 年，公司将秉持“关爱人，关爱环境，关爱社会”的企业可持续发展战略，持续践行可持续发展的长期承诺。公司将同各利益

相关方紧密合作，致力于推动企业社会责任的履行，共同构建和谐共赢的社会生态。

本报告所涉及的公司规划、发展战略等系非既成事实的前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意相关风险。

中芯国际集成电路制造有限公司董事会

2024年3月28日